



Das ACTECO Projekt ist ein Integriertes Projekt innerhalb des 6. Rahmenprogramm der EU. Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung von ökologisch-wirtschaftlichen Plasmaprozessen für Barrierschichten mit Anwendungen in der Textilindustrie, Lebensmittelverpackung und biomedizinischen Industrie

Dieser Workshop beinhaltet speziell Anwendungen für die Verpackungsindustrie.

28.10.2008	
17:00 - 18:30 Uhr 19:00 Uhr	Besichtigung Institut für Plasmaforschung (IPF), Universität Stuttgart Abendessen
29.10.2008	
Moderation: Prof. Dr. A.E. Ostermann	
09:00 Uhr	Plasmaprozesse für Verpackungen <i>Prof. Dr. H.-C. Langowski, TU München/FhIVV Freising</i> Plasmaprozesse für die Behandlung von Oberflächen, die Herstellung unterschiedlicher Schichten und das Abtöten von Mikroorganismen sind im Verpackungsprozess bekannt. Der Vortrag behandelt die wissenschaftlichen Grundlagen und die Funktionen der Anlagentechnik.
09:30 Uhr	Mikrowellen - Plasmatechnologie <i>Dr. K.-M. Baumgärtner, Fa. Mügge Electronic GmbH, Reichelsheim</i> Es werden Mikrowellen - Plasma - Verfahren sowohl für den Niederdruckbereich wie auch bei Atmosphärendruck vorgestellt und deren Leistungsfähigkeit zur Oberflächenbehandlung anhand von Anwendungen beschrieben.
10:15 Uhr	Barrierschichten für Lebensmittelverpackungen <i>J. Schneider, IPF, Universität Stuttgart</i> Mikrowellenplasmen ermöglichen es, hervorragende Barrierschichten auf Kunststoffen wie PET und PP abzuscheiden, die eine kostengünstige Alternative zu derzeit gebräuchlichen Verbundkombinationen darstellen.
11:00 Uhr	Kaffeepause
11:20 Uhr	Entkeimung mittels Mikrowellenplasmen <i>Dr. A. Schulz, IPF, Universität Stuttgart</i> Bei der Sterilisation von Lebensmittelverpackungen werden immer kürzere Taktzeiten verlangt, bei gleichzeitiger Umweltfreundlichkeit. Ein viel versprechender Ansatz ist die Sterilisation mit Plasmen.
12:00 Uhr	Plasmasterilisation von Oberflächen <i>Dr. H. Rauscher, ISPRA, Italien</i> Eine Sterilisationsmethode wird vorgestellt, die Effizienz, Wirksamkeit gegen Pathogene, breite Materialkompatibilität und Verzicht auf toxische Substanzen mit niedrigen Kosten und Umweltverträglichkeit verbindet.
12:45 Uhr	Mittagspause
13:45 Uhr	Plasmapolymerisation von ultradünnen Schichten für biomedizinische Anwendungen <i>Dr. C. Oehr, Fraunhofer IGB, Stuttgart</i> Plasmapolymerisation wird seit knapp 50 Jahren betrieben. Beide Aspekte der Plasmapolymerisation - Präparationsmöglichkeiten und Charakterisierung der Schichten - werden in diesem Beitrag betrachtet und an biomedizinischen Anwendungen dargestellt
14:30 Uhr	Industrielle Anwendung von Niederdruckplasma - Verfahren in der Verpackungsindustrie <i>W. Lohwasser, ALCAN Technology & Management LTD., Schweiz</i> ND - Verfahren als Vorbehandlung und zur Aufbringung von Haftvermittlern, Anwendungsbereiche von plasmaunterstützten Aufdampfverfahren zur Aufbringung von Barrierschichten, Anwendungsbereiche von reinen Plasmaverfahren für Barrierschichten
15:15 Uhr	Abschlussbetrachtung
15:30 Uhr	Schluss der Veranstaltung

Dieser Workshop findet am 29. Oktober 2008 im Telekom-Tagungshotel, Stuttgart statt.

Fragen sind zu richten an:

Prof. Dr. A.E. Ostermann
Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung e. V.
Schrägenhofstr. 35
80992 München - Deutschland
Tel.: 0049/089/149009-42
Fax: 0049/089/149009-80
Email: office@ivlv.de

CENTEXBEL
Mr. Guy Buyle
Technologiepark 7
BE-9052 Zwijnaarde - Gent
Belgium
e-mail: guy.buyle@centexbel.be



Hinweise zum Tagungsort und zur Anmeldung

Veranstaltungsort

Telecom-Tagungshotel, Universitätsstraße 34, 70569 Stuttgart
Tel. +49 711 6863 4060

Es ist ein Kontingent an Zimmern für 30 Personen zum Preis von 73 Euro incl. MWSt. reserviert unter dem Namen IVLV e.V., München. Der Teilnehmer nimmt die Reservierung in eigener Regie bis zum 10.10.2008 vor. Die Kontaktdaten des Hotels befinden sich auf der beigefügten Anreisebeschreibung.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt automatisch mit Überweisung der Tagungsgebühr von 40 Euro an die nachfolgende Bankverbindung mit dem Stichwort "ACTECO Workshop". In dieser Tagungsgebühr sind alle Nebenkosten für Verpflegung enthalten.

Bankverbindung

IVLV e.V.
Deutsche Bank, München
Konto 1820679
BLZ 70070024
SWIFT-/BIC Code: DEUTDEDBMUC
IBAN: DE 88 70070024 0182067900

Prof. Dr. A.E. Ostermann
Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung e.V.
Schrägenhofstr. 35
80992 München - Deutschland
Tel.: 0049/089/149009-42
Fax: 0049/089/149009-80
Email: office@ivlv.de

CENTEXBEL
Mr. Guy Buyle
Technologiepark 7
BE-9052 Zwijnaarde - Gent
Belgium
e-mail: guy.buyle@centexbel.be